

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203174958 U

(45) 授权公告日 2013.09.04

(21) 申请号 201320172016.1

(22) 申请日 2013.04.09

(73) 专利权人 福建省万旗科技陶瓷有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇丁
溪村鹏祥工业区

(72) 发明人 罗伟 张金池

(51) Int. Cl.

E04F 13/077(2006.01)

E04F 13/076(2006.01)

B32B 3/12(2006.01)

B32B 15/04(2006.01)

B32B 18/00(2006.01)

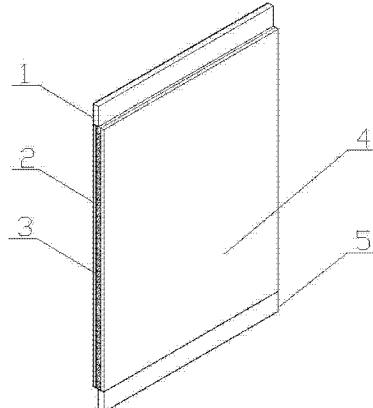
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种墙面陶瓷板

(57) 摘要

本实用新型提供一种不易碎而且能牢靠粘接于墙面的墙面陶瓷板。本实用新型中，陶瓷板本体由外层、芯层和里层三层结构叠合而成；外层和里层为陶瓷材料制作的陶瓷层；外层和里层之间制作钢丝层，钢丝层为上述芯层；陶瓷板本体的顶部和底部分别制作有用于将两块以上的陶瓷板进行拼接的长方体形状的凸起，分别为顶部拼接块和底部拼接块。进一步的是：上述钢丝层由交错排布的细孔径钢丝网组成。更进一步的是：上述顶部拼接块和底部拼接块分别布置在陶瓷板本体的两侧，上下两块陶瓷板拼接后，陶瓷板本体的外表面和内表面平齐。优选的是：上述里层靠近墙面一侧上制作有用于增加陶瓷板本体与墙面粘接力的凹凸纹理。



1. 一种墙面陶瓷板,其特征在于:陶瓷板本体由外层(4)、芯层和里层(2)三层结构叠合而成;外层(4)和里层(2)为陶瓷材料制作的陶瓷层;外层和里层之间制作钢丝层(3),钢丝层(3)为上述芯层;

陶瓷板本体的顶部和底部分别制作有用于将两块以上的陶瓷板进行拼接的长方体形状的凸起,分别为顶部拼接块(1)和底部拼接块(5)。

2. 如权利要求1所述的一种墙面陶瓷板,其特征在于:所述钢丝层(3)由交错排布的细孔径钢丝网组成。

3. 如权利要求1所述的一种墙面陶瓷板,其特征在于:所述顶部拼接块(1)和底部拼接块(5)分别布置在陶瓷板本体的两侧,上下两块陶瓷板拼接后,陶瓷板本体的外表面和内表面平齐。

4. 如权利要求1所述的一种墙面陶瓷板,其特征在于:所述里层(2)靠近墙面一侧上制作有用于增加陶瓷板本体与墙面粘接力的凹凸纹理。

一种墙面陶瓷板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑材料,具体涉及一种墙面陶瓷板。

背景技术

[0002] 墙面陶瓷板(也叫瓷片、墙面砖等),由于其表面制作釉层后具有美观大方的特点,作为中国传统工艺和文化的体现,深受大多数人的喜爱;但是美中不足的是,人们在墙面陶瓷板的运输、安装以及日常生活使用中,容易造成墙面陶瓷板的破碎,这给人们的使用带来的不便和局限。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种不易碎而且能牢靠粘接于墙面的墙面陶瓷板。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种墙面陶瓷板,陶瓷板本体由外层、芯层和里层三层结构叠合而成;外层和里层为陶瓷材料制作的陶瓷层;外层和里层之间制作钢丝层,钢丝层为上述芯层;

[0005] 陶瓷板本体的顶部和底部分别制作有用于将两块以上的陶瓷板进行拼接的长方体形状的凸起,分别为顶部拼接块和底部拼接块。

[0006] 进一步的是:上述钢丝层由交错排布的细孔径钢丝网组成。

[0007] 更进一步的是:上述顶部拼接块和底部拼接块分别布置在陶瓷板本体的两侧,上下两块陶瓷板拼接后,陶瓷板本体的外表面和内表面平齐。

[0008] 优选的是:上述里层靠近墙面一侧上制作有用于增加陶瓷板本体与墙面粘接力的凹凸纹理。

[0009] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

[0010] 本实用新型墙面陶瓷板,在烧制本墙面陶瓷板时,选用网孔较小的钢丝网作为芯层,形成钢丝层,然后将钢丝层的两侧用陶瓷材料制作的外层4和里层2进行包裹;从而增加了本实用新型墙面陶瓷板的坚韧度,不易破碎,能够安全运输;同时也保证了粘接于墙面后不易破碎;为了保证本实用新型陶瓷板在粘接于墙面后不易脱落,我们在陶瓷板上下端,制作了拼接块;该拼接块增加了陶瓷板本体之间的粘接面积,保证了陶瓷板之间的牢靠性;

[0011] 本实用新型墙面陶瓷板相互拼接后,从外观看(如图2所示)还是只有一条拼接线,整体表面平齐;但是却相比传统对接的(没有拼接块)结构,增加了粘接材料的涂覆面积,最终增加了粘接后的牢靠性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型单个陶瓷板的立体结构示意图;

[0013] 图2为两个陶瓷板上下拼接后的效果示意图。

[0014] 附图标记说明：

[0015] 1- 顶部拼接块, 2- 里层, 3- 钢丝层, 4- 外层, 5- 底部拼接块。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及实施例描述本实用新型具体实施方式：

[0017] 如图 1、图 2 所示, 其示出了本实用新型的一种具体实施方式, 本实用新型一种墙面陶瓷板, 陶瓷板本体由外层 4、芯层和里层 2 三层结构叠合而成; 外层 4 和里层 2 为陶瓷材料制作的陶瓷层; 外层和里层之间制作钢丝层 3, 钢丝层 3 为上述芯层;

[0018] 陶瓷板本体的顶部和底部分别制作有用于将两块以上的陶瓷板进行拼接的长方体形状的凸起, 分别为顶部拼接块 1 和底部拼接块 5。

[0019] 上述的陶瓷板本体是指整个陶瓷板, 陶瓷板本体用于通过建筑材料(混凝土等)粘接于墙面, 其靠近墙面的表面为内表面, 其远离墙面的表面为外表面;

[0020] 在烧制本墙面陶瓷板时, 选用网孔较小的钢丝网作为芯层, 形成钢丝层, 然后将钢丝层的两侧用陶瓷材料制作的外层 4 和里层 2 进行包裹; 从而增加了本实用新型墙面陶瓷板的坚韧度, 不易破碎, 能够安全运输; 同时也保证了粘接于墙面后不易破碎; 为了保证本实用新型陶瓷板在粘接于墙面后不易脱落, 我们在陶瓷板上下端, 制作了拼接块; 该拼接块增加了陶瓷板本体之间的粘接面积, 保证了陶瓷板之间的牢靠性。

[0021] 优选的, 上述钢丝层 3 由交错排布的细孔径钢丝网组成, 这里所说的细孔径是指钢丝的孔径; 我们将能称作钢丝的钢材均可以理解为细孔径。

[0022] 一般的, 上述顶部拼接块 1 和底部拼接块 5 分别布置在陶瓷板本体的两侧, 上下两块陶瓷板拼接后, 陶瓷板本体的外表面和内表面平齐。整个墙面陶瓷板相互拼接后, 从外观看(如图 2 所示)还是只有一条拼接线, 整体表面平齐; 但是却相比传统对接的(没有拼接块)结构, 增加了粘接材料的涂覆面积, 最终增加了粘接后的牢靠性。

[0023] 为了进一步增加单片陶瓷板与墙面之间的牢靠性, 上述里层 2 靠近墙面一侧上制作有用于增加陶瓷板本体与墙面粘接力的凹凸纹理。所述凹凸纹理不仅增加了陶瓷板本体与墙面的摩擦力, 与此同时还增加了填充粘接材料的面积, 进一步增加了粘接可靠性。

[0024] 上面结合附图对本实用新型优选实施方式作了详细说明, 但是本实用新型不限于上述实施方式, 在本领域普通技术人员所具备的知识范围内, 还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化。

[0025] 不脱离本实用新型的构思和范围可以做出许多其他改变和改型。应当理解, 本实用新型不限于特定的实施方式, 本实用新型的范围由所附权利要求限定。

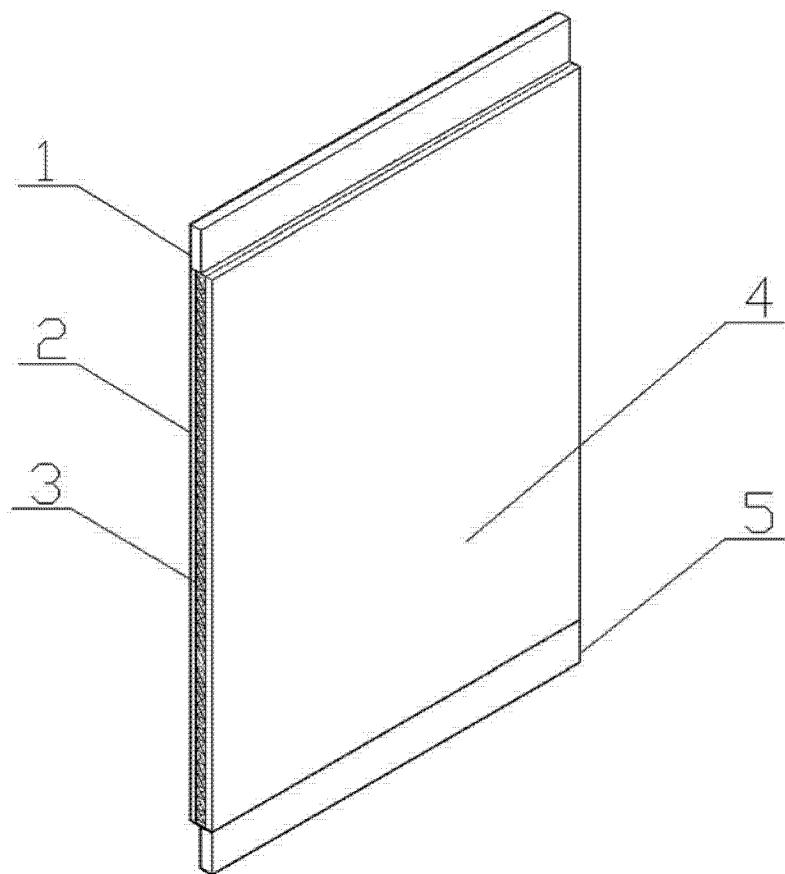


图 1

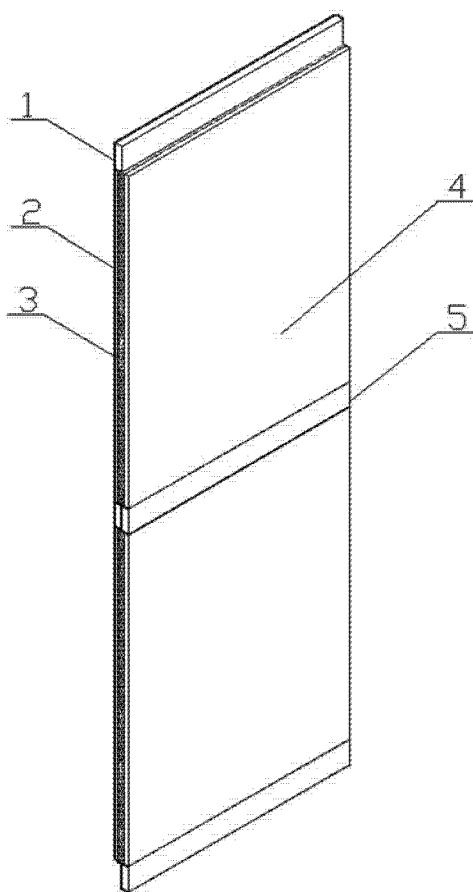


图 2